



# 8430

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปติด HAF สีเหลือง ทำปฏิกิริยาไฟฟ้า 45µm

### Product Description

tesa® HAF 8430 เป็นแผ่นฟิล์มกาวสีเหลืองอำพันสองหน้า ทำงานโดยใช้ความร้อน ผลิตจากพีนอลิกเรซินและยางไนไตรล์

คุณสมบัติพิเศษ:

- สามารถยึดเกาะแผงวงจรได้ดี
- เหมาะสำหรับ PVC, ABS, PET และ แผง PC
- ใช้งานได้ดีกับ implanting lines ทั่วไป
- ทนต่อการเสื่อมสภาพได้อย่างดี
- มีความยืดหยุ่นตลอดการใช้งานเนื่องจากมีปริมาณยางสูง

คุณสมบัติ

- Reliable chip module bonding
- Suitable for PVC, ABS, PET, and PC cards
- Good workability on all common implanting lines
- Outstanding ageing resistance
- Lifelong flexibility due to high rubber content
- At room temperature tesa HAF® 8430 is not tacky.

การใช้งาน

tesa® HAF 8430 ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการฝังชิปโมดูลลงในสมาร์ตการ์ด

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

• Backing	none	• Total thickness	45 µm
• Type of adhesive	nitrile rubber / phenolic resin	• Color	สีเหลืองอำพัน
• Type of liner	glassine		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Bonding strength (dynamic shear)	12 N/mm <sup>2</sup>
------------------------------------	----------------------

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำทางเทคนิคสำหรับการใช้งานกับสมาร์ตการ์ด:

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=08430>



# 8430

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### ข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าต่อไปนี้ เป็นคำแนะนำสำหรับค่าพารามิเตอร์ของเครื่องที่จะใช้เบื้องต้น

โปรดสังเกตว่าค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่อง รวมทั้งวัสดุที่ใช้สำหรับตัวการ์ด ชิปโมดูลและข้อกำหนดของลูกค้า

1. การเคลือบติดเบื้องต้น:

ช่วงการเคลือบติดเบื้องต้น

เทปแก้วได้รับการเคลือบบนสายพานโมดูลขั้นตอนก่อนเคลือบไม่ส่งผลกระทบต่ออายุการเก็บรักษาของเทปสายพานโมดูลที่ได้รับการเคลือบสามารถตั้งค่าเครื่อง:

- อุณหภูมิ 120 – 140 °C
- แรงกด 2 – 3 บาร์
- เวลา 1.5 – 2.0 ม./นาที.

2. การฝังโมดูล:

ระหว่างการผลิต

โมดูลที่เคลือบจะถูกไต่จากสายพานโมดูลและถูกวางเข้าไปในโพรงของบัตรและติดอย่างถาวรเข้ากับตัวบัตรโดยความร้อนและแรงกด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการผลิต สามารถใช้วิธีการขั้นตอนกดทับเดียวหรือกดทับหลายครั้ง

ปัจจุบันเครื่องติดชิปส่วนใหญ่ใช้แรงกดด้วยความร้อนแบบหลายครั้ง

การตั้งค่าเครื่อง - กดทับขั้นตอนเดียว:

- อุณหภูมิ<sup>1</sup> 180 – 220 °C
- แรงกด 65 N/โมดูล
- เวลา 1.5 วินาที

กระบวนการกดทับหลายขั้นตอน(การกดอัดด้วยความร้อน 2 ครั้งหรือมากกว่า) - การตั้งค่าเครื่อง:

- อุณหภูมิ<sup>1</sup> 180 – 220 °C
- แรงกด 65 N/โมดูล
- เวลา 2 x 0,7 วินาที / 3 x 0.5 วินาที

<sup>1</sup> เป็นอุณหภูมิตามที่วัดภายในเครื่องกดอัดด้วยความร้อน การตั้งค่าอุณหภูมิที่แตกต่างกันมีแนะนำสำหรับวัสดุบัตรที่แตกต่างกัน ดังนี้:

PVC 180 - 190 °C

ABS 180 - 190 °C

PET 190 - 200 °C

PC 200 – 220 °C

ค่าความแข็งแรงของการติดได้รับภายใต้ทดสอบในสภาวะห้องปฏิบัติการมาตรฐาน

ค่าได้รับการตรวจสอบด้วยจำนวนจำกัดในแต่ละชุดการผลิต (วัสดุ: ชิ้นงานทดสอบ Etchedอะลูมิเนียม/ สภาวะการติด: อุณหภูมิ = 120 °C; p = 10 บาร์; เวลา = 8 นาที)

เพื่อการติดที่แข็งแรงสูงสุด พื้นผิวจะต้องสะอาดและแห้ง สภาพการเก็บรักษาเป็นไปตามมาตรฐานอายุการใช้งาน tesa® HAF



# 8430

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=08430>